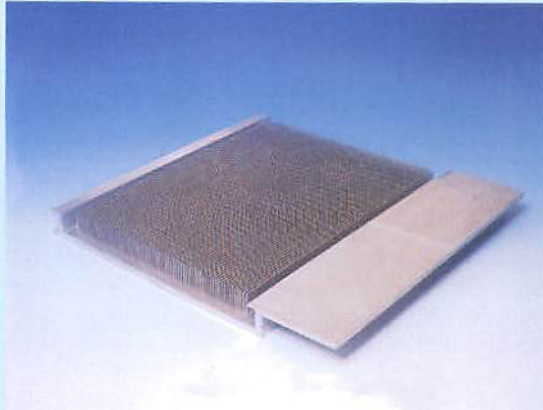
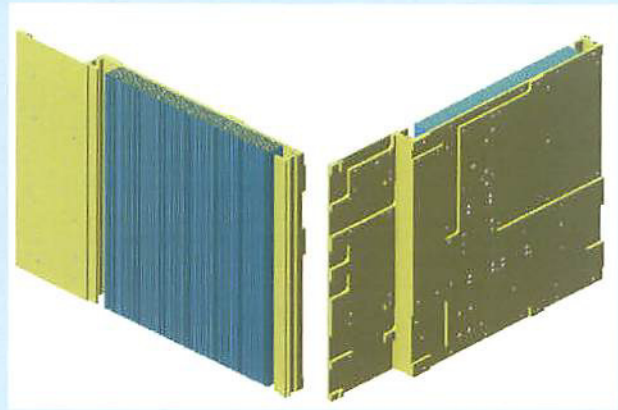


Hiシンク・SP

(機種タイプ : 型材ベース)



古河スカイのアルミ叩付けヒートシンク・シリーズ



〈写真1〉: 型材ベースに楕形フィンを組み合わせた製品例 〈図1〉: 〈写真1〉のイラスト図(左側: 放熱面, 右側: 部品実装面)

■ 製品の用途例

①通信機器, ②小型電源装置, ③一般電子機器, ④その他

■ 製品の特長

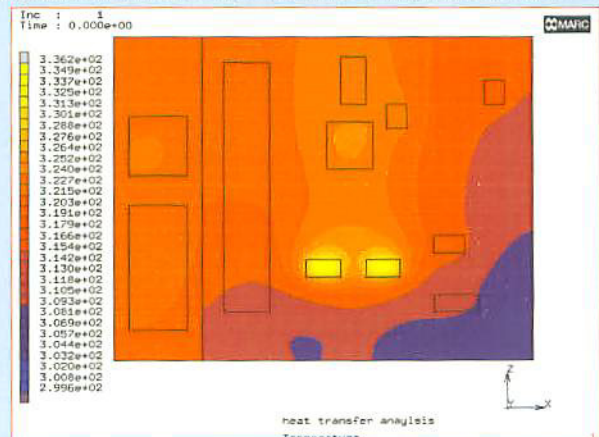
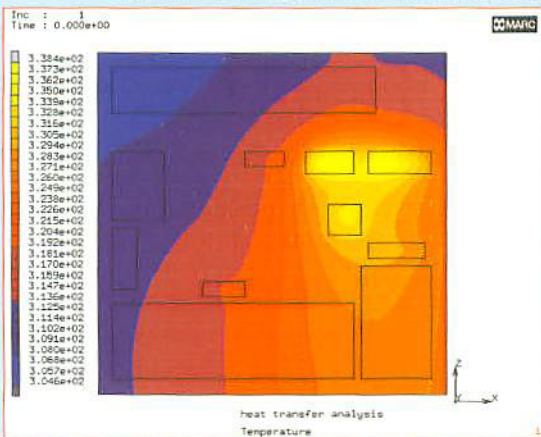
- ①組み合わせるフィンは楕形フィン, 格子フィン, コルゲートフィンのいずれでも可能であり, 取り付け位置と通風方向を自由に設計出来ます。
- ②型材ベースと各種のフィンとの設計自由度の高い組み合わせが可能であり, 複雑な構造のヒートシンクを製作出来ます。
- ③例えば, 実装回路基板とヒートシンク機構とを一体化した, ハイブリッド機能の用途展開が可能です。

■ 製品の構造

- ①HiSink-SPは複雑な断面形状の押出型材をベースにして, その一部にフィンをアルミ叩付けした構造のヒートシンクです。
- ②〈写真1〉の製品例では, 型材ベースの裏面にパワー素子(パワートランジスタ)の装着用の衺穴加工が施され, 同時に回路基板上に実装された複数部品間の高さ合わせ用に座繰り加工が施されています。

■ 熱設計シミュレーション例

- ①HiSink-SPは任意の断面形状の型材ベースと各種のフィンを組み合わせるため, 押出型材用金型を手配する前に, 最適熱設計の確認が不可欠です。
- ②〈図2〉は同一の型材ベース(〈図1〉の右側イラスト図の形状)の中での, 実装部品レイアウトの違いによる温度分布差を熱シミュレーション解析した例で, 最高発生温度とその位置を事前確認したものです。



〈図2〉: 部品実装レイアウトの違いによる温度分布差のシミュレーション例 (右側のレイアウトの方が均熱効果が良好。)